

第 9 図

第 10 図

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-250698

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)11月8日

H 05 K 7/20

G 7301-4E

審査請求 有 請求項の数 3 (全9頁)

60発明の名称 3

キャピネットの冷却構造

②特 願 平2-22500

②出 願 平2(1990)2月1日

勿発明者
ジョセフェイチ。プ

ランチヤード

アメリカ合衆国,テキサス州,リチヤードソン,イー.キ

ヤンベル ロード1100

⑦発明者 アール シー、バーブ

アメリカ合衆国、インデイアナ州、マンチエ、イー、メモ

リアル ドライブ2200

個発明者 小島

康

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

勿出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 井桁 貞一 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

キャビネットの冷却構造

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 電子機器を格納する密閉型キャビネットの冷却構造であって、

ベース部分と、

当該ベース部分から直立し、動作時に熱を発生 する電子機器を収納するための内室を形成する長 手方向の対向側壁と左右の対向端面壁と、

それぞれが対向端面壁の上方部分に設けられた 1 対の通気孔と、

当該通気孔間に配置され、左右端面壁の一方から他方に向かって延設された底壁によって当該内 室の上方部分から隔離されている空気ダクトと、

その一部が空気ダクトの底壁内に位置し、その 一部が内室内に位置して、電子機器から発生した 熱を空気ダクトに伝達するための熱交換手段と、

外気を空気ダクトに送り込むことによって、電子機器から発生した熱を除去するための手段とか

ら構成されたキャビネットの冷却構造。

- (2) 前記熱交換手段は少なくとも1つの冷却フィン機構から構成され、該冷却フィン機構はキャビネットの上方部分に取り付けられ、空気ダクト内の位置する上方部分と内室内に位置する下方部分とからなる請求項(1)記載のキャビネットの冷却構造。
- (3) 前記空気ダクトは、各々が基端部と終端部をもつと共に、それぞれの基端部が通気孔のがまったの対向端面壁に接続され、終端部のキャビネットの上面に向かって上方に延びている1対の傾斜板と、傾斜板に接続されると共にのを発したがあるとはないの底壁である。 (3) 前記空気ダクトは、終端部の本・ビネットの対向端面壁に接続され、終端部のの対向端面壁に接続されると共にのがる1対の傾斜板となるをといる。 (4) では、本・ビネットの底壁である。 (4) では、本・ビネットの底壁である。 (5) では、本・ビネットの対向側壁とといるに、まって下方に延びた1対の対向側壁とといるによって下方には、からで気がした。 になる請求項(1)記載のキャビネット。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

電子機器を格納するとは、
を格納するとは、
をを格納を関型キャビネックのは、
をでは、
をでは、
をでは、
をでは、
をでは、
をでは、
をでは、
をできるが、
をのののできるが、
をののできるが、
をのののできるが、
をののできるが、
をのいできるが、
をのいでき

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子機器を格納するキャビネットに関 し、更に詳しくは、キャビネット内部発生熱を除 去するためのキャビネットの冷却構造に関する。

機構、即ち、追加設置型の構成となっているので、 キャピネットの他の部分とのまとまりが悪く、最 適な冷却性能が得られない。さらに、大部分は、 冷却ファンによって発生する冷却空気流の通路孔 をキャピネットに設ける必要がある。アドオン機 構はできるだけコンパクト化する傾向にあること から、このような場合ファンを設けること自体が、 コンパクト化の妨げとなる。

公知のアドオン冷却機構について第10回を参が 20で示されている。この機構20は、キャことの よっト22の上面22に接続可能に気孔24を開けるななった。 よった22に接続可能に気孔28を開けるななった。 まった22に接続可能に気孔を る。キャビネット22に接続可に近れる。 30が設けられ、空気が矢ン30からにでいた。 る。か設けられ、空気が矢ン30からにでなった。 るように機構の一方の側により出さたようにないる。 おいで気が矢示のにようなようにないる。 とは冷却フィン機構32を通って、 る。とは冷却フィン機構32を通って、

〔従来の技術〕

しかしながら、従来の冷却装置の大部分は電子 部品を格納するキャピネット内部の室内に入り込 む構造であり、冷却装置がキャピネット内部の室 内への水の通り道となる可能性がある。

また、公知冷却装置は、大部分が「アドオン」

機構20から吹き出される。冷却フィン機構32 は冷却液コイルからなっている。

(発明が解決しようとする問題点)

第10図を参照して説明した機構は、公知冷却装置に関連する問題をもっている。1つの問題は、この機構をキャビネットの上面に設置すると、それを遮蔽するものがなく、水が接続孔24を通り抜け、通気孔28と30に入り込むので、室外で使用することができないことである。また、ファン30は露出しているので、水による損傷を受けやすいことである。

また第10図に示すような公知の冷却装置では、 ファン30は、機構全体を取り外さなければ、保 守点検ができないので、保守は非常に面倒なもの となる。

最後に、第10図に示すように、空気流が垂直 方向に流れる冷却機構は、出入りする空気の流れ がキャピネットの一部分に存在し、冷却にばらつ きがあるので、冷却装置の効率が低下する傾向が ある.

本発明の目的は、冷却装置が一体構造になった電子機器格納用キャピネットを提供することである。

また本発明の別の目的は、キャビネット内部部品や冷却装置部品がエレメントに露出するのを可能な限り少なくした電子機器格納用キャビネットを提供することである。

〔問題点を解決するための手段〕

上記およびその他の目的を達成するために、、本発明による電子機器格納用キャビネット34を支えるではまった。 動作はなったのの直立して、動作を定るできるでは、ベース36から直立して、動作を定るでは、ベース36から直立して、動作をを表するでは、ベース36から直がした。 48と、両側の側壁および右の端壁を覆う上面38と、それぞれが左右の端壁を覆う上面38と、それぞれが左右の端壁を覆う上面38と、それぞれが左右の端壁を覆う上面38と、それぞれが左右の端壁を覆う上面38と、大きに通気孔64、66と、内室の上方のキャビネット上部に通気孔間に配

ている。

(作用)

熱交換器 8 2 、 8 4 により、キャビネット内室 5 0 内で発生した熱は、空気ダクト 6 2 に導かれる。そして、空気ダクト 6 2 に導びかれた熱は、 通気孔 6 4 、 6 6 によって生ずる空気流(図中、 A I R F L O W の矢印で示される)によって、 放熱される。

空気ダクトおよび熱交換器は、完全にキャビネット内に内蔵されており、密閉型の間接冷却機構を提供しており、キャビネット外部に露出した機構を無くし、且つ、内蔵型であるため、外気からの水滴の流入等を防止できる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。

第1図は、本発明の一実施例による電子機器格納用キャビネットの概略図である。

置された空気ダクト62と、その一部が空気ダクト内に位置し、その一部が内室内に位置して、電子機器から発生した熱を空気ダクトに誘導するための熱交換器82,84と、外気を空気ダクトに送り込んで、電子機器から発生した熱を除去するための手段とから構成されている。

第1図に示すように、キャビネット34は、コンクリート・パッドまたは他の適当な支台にキャビネットを載置するためのベース部分36を備えている。上面38はベース部分36から直立して、動作時に熱を発生する電子機器を取り付けるための内室50を形成する対向側壁と左右端面壁46と48を覆っている。例えば、キャビネット34内には、各種プリント板パッケージ、DC電源装置、サージ保護装置、パックアップ用の電池等が格納される。

キャビネットは、1/8インチ厚アルミ・シートで構成し、露出する雑ぎ目はすべて完全に溶接することが好ましい。キャビネット・ボディと内部パネルにはポリエステル粉末塗装が施されている。

キャピネット34の上部はキャピネットと一体になった冷却装置40が設けられている。冷却装置34の各種構成部品とキャピネット34の詳細構造について、以下第1図~第8図を参照して説明する。

第2図および第3図に示すように、キャビネッ トは、左右の端面壁46と48と共に、ベース部 分36から直立している1対の長手方向対向側壁 42と44から構成されている。上面38は対向 倒壁42と44および左右端面壁46と48を覆 うことによって、内室50を形成し、この中に動 作時に熱を発生する各種電子機器が取り付けられ るようになっている。第1図~第8図に示すキャ ビネットは約86インチ長、34インチ奥行、66 インチ高さであり、その中に10インチ高さの取 付け基板が含まれている。取付け基板は着脱可能 な端面カバーが付いており、ケーブル、AC電源 供給線、パッド取付けボルトがアクセスできるよ うになっている。ケープル支持ラック52(第3 図)、バッテリ棚54、その他の取付け構造物56 が内室50内に設けられ、各種構成部品がキャビ ネット34内に取り付けられるようにしている。

キャビネットは前面と後面に機器を点検するためのドアが付いている。従って、第2図において、 側壁42は、実際には、キャビネットの長手方向

に水滴が入り込むのを防止する働きをする。ドアの周囲にガスケットを設ければ、風雪、埃、雨などが入り込むのを防止することができる。

熱交換器68とキャビネット34の上面38は空気ダクト62の一部を構成している。もっと具体的に説明すれば、対の傾斜板74と76は、そ

の対向端に設けられた連続ステインレス・スチール・ヒンジ(図示せず)によって、キャビネット・ボディに取り付けられた2重ドアになっている。これらのドアは3点式ラッチ機構(図示せず)によってラッチが掛けられる。このラッチ機構は機械的にインタロックし、ナンキン錠になっている。この機械的インタロック機構は自動ロック式で、アレン・レンチで操作するようになっている。

れぞれ、その基端が通気孔64と68の下方のキャビネット34の向き合う端面壁46と48に取り付けられ、その終端がキャビネットの上面38に向かって延びている。縦長の仕切板78は傾斜板74と76に接続され、その終端間に延設されている。傾斜板74と76および縦長仕切板78は、一方の対向端面壁46から他方の端面壁に向かって延びた空気ダクト62の底壁80を形成している。

縦長仕切板78は開口が設けられ、その中に第 1 図に示すように1 対の冷却フィン機構が収められている。

第3図に示すように、冷却フィン機構84は、 縦長仕切板78に取り付けられている。冷却フィン機構84の上部81は空気ダクト62内に入り 込んでおり、下部83は下方に向かって内室50 内に入り込んでいる。

第4図と第5図は、冷却装置の一方の端部を詳細に示したものである。端面壁48には通気孔86が設けられ、スクリーンとルーバが付いた通気カ

バー(図示せず)を受け入れるようにしている。傾斜板76は通気孔86を取り巻く支持板88に接続されている。傾斜板76は、フランジ90によって转板88に接続されている。さらに、反対側の端のフランジ92によって、この傾斜板76かはよって、対向側壁93とり4およびキャビネットの拡大部がの対応される。空気ダクトの反対側の端も同じような構成になっている。

空気ダクトの反対側の端の拡大部は、ファン70と72の取付けを容易にするために設けられたものである。ファン72は、取付け板102によって傾斜板76に支えられているハウジング100内に取り付けられている。ファン72(および反対側のファン70)を冷却フィン機構が設けられている空気ダクトの中心部に対して角度をなして取り付けると、空気ダクトの長さ方向の主要部に

は穴116が設けられており、上面と穴116に 挿通されるアイボルトを受け入れるようになっった いる。アイボルト(図示せず)は、キャビネット を持ち上げて、そのパッド上に位置付けて、そこ に取り付けるときに使用できる。正しい位置になったら、美観上アイボルトを取り除くことも取り けけたままにしておくことも可能である。取り 除く場合は、キャビネットの上面の対応する穴を プラグやカバーで隠すことが可能である。

再び第3図に示すように、ビーム104と106の内部側壁108と110は仕切板78の下端まで下方に延びているので、仕切板78の下の内室の総断面積は冷却フィン機構84の下方部分83と連絡している。従って、キャビネット内の特定の個所で発生した熱は、2個の冷却フィン機構の下方部分に伝えられることになる。

次に、第6図と第7図を参照して、冷却フィン 機構84の詳細を説明する。この機構は、スペーサ・バー118によって間隔が置かれた複数のフィン117から構成されている。スペーサ・バー 対して大径のファンが使用できるので、空気流量 と冷却能力が向上することになる。さらに、保守 のための点検がしやすくなる。

ファン・ハウジング100のベース部分101は、ねじ付きファスナ、リベット、溶接といった従来の方法で取付け板102に接続可能である。ファン・ハウジング100のバンド部分132はベース部分101上に形成されている。内蔵ファン機構は、回転可能な羽根と駆動モータを備えており、バンド部分132にはめ込むことが可能である。

空気ダクトの両側にピーム 1 0 4 と 1 0 6 が設けられ、その側壁 1 0 8 と 1 1 0 は空気ダクト62の側壁となっている。ピーム側壁 1 0 8 と 1 1 0 の対向端部は、それぞれ、対向側壁と重なり合っていて、空気ダクトの一端側から他端側に向かって連続壁を形成している。しかし、この重なり合いはなくてもよい。ピーム 1 0 4 と 1 0 6 の 上壁 1 1 2 と 1 1 4 は、それぞれ、キャピネットの上面 3 8 に接続されている。上壁 1 1 2 と 1 1 4 に

118の上方のフィン117部分は、冷却フィン 機構の上方部分を構成し、空気ダクト内に入り込 んでいる。他方、スペース・バー118の下方に 延びた下方部分は冷却フィン機構の下方部分を構 成している。フィン117とスペーサ・バー118 は、これらに所定間隔で設けた位置合わせ穴にね じ付きロッド120を通すことによって、結合さ れる。ねじ付きロッド120はヘッド端と、ねじ 付きナットを受け入れる端とをもっている。アン グル・バー122と124にも、その垂直部分に ねじ付きロッド120を受け入れるための穴が設 けられている。フィン機構を組み立てるときは、 フィン117とスペーサ・パー118を互い違い に積層し、その積層物の両端をアングル・バー 122と124で固定する。次に、積層物の位置 合わせ穴にねじ付きロッド120を通し、ヘッド 端の反対側のロッド端にナットをはめて、ねじ付 きロッドをねじ留めし、フィン機構構成部品を締 結する。スペーサ・バー118はフィン117の 全長にわたっているので、フィンの上方部分と下

方部分との間のスペーサ・バー118に強固な壁が形成されることになる。この壁は、仕切板78に設けられた開口内に組み立てられるとき、空気ダクトの底と一体になる。仕切板78の水平部分とアングル・バー122、124は、ねじ付きファスナ、リベット、溶接といった適当な方法で接合することが可能である。

エンド・アングル・バー126はボルトまたは他の方法によって、フィン117の軸方向の反対側の端と結合され、これによって冷却フィン機構は仕切板78に取り付けられる。仕切板78は単独でビーム104、106の側壁に接続可能である。また、仕切板の反対側の端は傾斜板76のフランジ92に接続される。

フィンとスペーサ・バーの穴の位置合わせは長さが大きくなると、困難になるので、フィン機構は、1つのフィン機構をキャビネット全長に渡って設けるよりも、第1図に示すように2つにするのが好ましい。

フィン機構のスペーサ・バーとフィンは、アル

は、外気に熱を伝達する個所として働く。空気ダ クト62は内室の他の部分から密閉されているの で、水や埃がキャビネットに入り込んで、キャビ ネット内に格納されている部品に損傷を与えるこ とがない。外気を空気ダクトに送り込むファンは 空気ダクトの対向端に位置しており、補完的な働 きをする。つまり、一方は空気をダクトに引き込 み、他方は空気をダクトから送り出す。前述した 寸法のキャビネットの場合は、ファンは6インチ 径であり、48ボルト(直流)で動作し、50℃ で電源が入り、40℃で電源が切れるようにサー モスタットで制御される。このサーモスタット制 御を行なうために、第1図に示すように、ファン 70と72はコントローラCに接続されている。 このコントローラは集積回路と、温度検出機能を もつりレーと、検出温度に応じてファンを断接す るスイッチとで構成されている。DC電源はコン トローラに接続され、ファン70と72に電力を 供給し、その充電はAC電源に接続されたパッテ リ充電装置によって行なわれる。

ミ・シートをカットまたは打ち抜いて形成するが、 図面に示すものとほぼ同じように、構造全体を 1 つの部品としてモールド成形する方法も可能であ

第8図は、端面壁48の内側の面49を示した ものである。図示のように、通気孔86はほぼ四 角であり、その中心に支持板88がある。この支 持板88は溶接または他の適当な方法で取り付け ることが可能である。

第9図はルーバ付き通気カバー128を示しており、このカバーは通気孔86と同一面になるようにはめ込まれ、支持板88に設けられた穴131にねじ込まれている。スクリーン130は独立のは過気カバー128の裏側に取り付けられるか、あるいは通気カバー128と一体に設けられる。通気カバーの縁を折ま曲げて、スクリーンをカバーに取り付ける。

図示キャビネットの冷却装置は、内部温度を65 で以下に保つ設計になっている。冷却フィン機構

キャビネット上面は第5図および第6図に示す 絶縁層134のような、フォイル絶縁材で絶縁されている。絶縁材は、抵抗(R)値が9.2の REFLECTIX バブル・パック・フォイル絶縁材という商標名で販売されているものが好ましい。絶縁の主目的は、太陽の放射熱を減少することである。絶縁の二次的効果は、外気温度が周期的にまたは急激に変化したとき、内部温度を一定に保つことである。また、絶縁は、酷寒状態から保護する働きもする。

酷寒環境下で設置する場合には、第3図に示す パッテリ棚54にヒークを付けることが可能である。ヒータ(図示せず)は15A,120V AC 回路に接続され、0℃でオンに、15℃でオールに なるようにサーモスタットで制御される。 は、オオプレン・ラバー・シート間を金属とーク は、抵抗性素子を巻き付けて構成する。各ヒータ は定格出力が約225ワットであるので、4Aヒ ューズで保護する必要がある。この種のキャ・プ ットには、100A負荷センタ,サーキット・プ レーカ、2重コンセント、電圧サージ保護装置からなるAC電源システムが付いているのが普通であるので、AC電源が使用可能である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、一体型 で、かつキャビネットに内蔵された冷却機構を提 供される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による電子機器格納用キャビネットの概略図、

第2図は本発明による電子機器格納用キャビネットの好適実施例を示す斜視図、

第3図は第2図に図示のキャピネットの断面図、 第4図は第2図のキャピネットに組み込まれた 冷却ファン機構の一部を示す部分平面図、

第5図はキャピネットの上面、ファンおよび支持構造からなる第4図図示の構造の側面図、

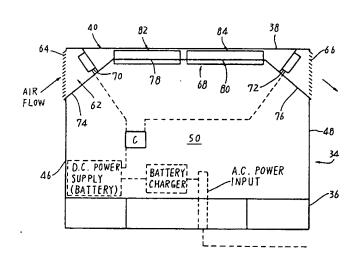
第6図は第3図図示の冷却ファン機構の拡大図、 第7図は第6図図示の冷却ファン機構の一部展 開斜視図、

第8図は第2図のキャビネットの左右端面壁の 一方の裏側を示す部分図、

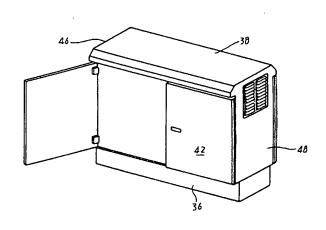
第9図は第2図に図示のキャビネットの対向端面に設けられたルーバ付き通気孔の一方を示すー 部破切側面図、

第10図は公知の冷却装置を示す一部展開図、 である。

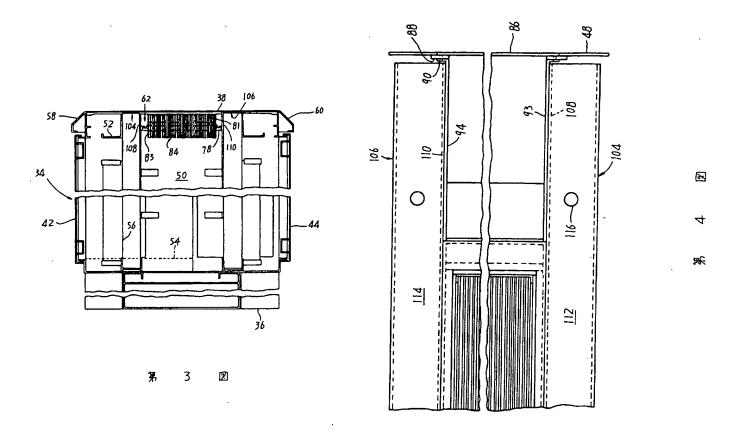
代理人 弁理士 井 桁 貞 一

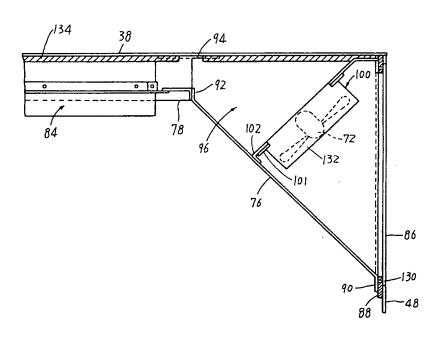






第 2 図





第 5 図

PAT-NO: JP403250698A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03250698 A

TITLE: CABINET COOLING STRUCTURE

PUBN-DATE: November 8, 1991

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
JIYOSEFU, EICHI BURANCHIYAADO
AARU, SHII BAABU
KOJIMA, YASUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY FUJITSU LTD N/A

APPL-NO: JP02022500

APPL-DATE: February 1, 1990

INT-CL (IPC): H05K007/20

US-CL-CURRENT: 361/690

ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate the need of a mechanism exposed to the $\underline{\text{outside of a}}$ $\underline{\text{cabinet}}$ and prevent any water droplet from entering from fresh air by guiding heat produced in the $\underline{\text{cabinet}}$ by a heat exchanger into an air stream entering through a vent hole.

CONSTITUTION: A <u>cabinet</u> 34 comprises left and right end walls 46, 48 and a pair of longitudinally opposing side walls 42, 44 located vertically on a base part 36. The upper surface 38 forms an inner chamber 50 covering therewith the opposing side walls 42, 44 and the left and right end walls 46, 48, in which various electrical instruments producing heat upon operation are mounted. An air duct 62 of a cooling device 40 extends from one of the left and right end surfaces of the <u>cabinet</u> 34 to the other of the same between a pair of vent holes 64, 66 provided in the upper part of the opposing end walls 46, 48. A <u>heat exchanger</u> 68 resides partly in the air duct 62 and partly in the inner chamber 50, for guiding heat produced from the electronic instruments into the air duct. The upper part 81 of a cooling fin mechanism 84 enters the air duct 62 and the lower part 83 of the same enters the inner chamber 50 toward the lower portion.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO& Japio